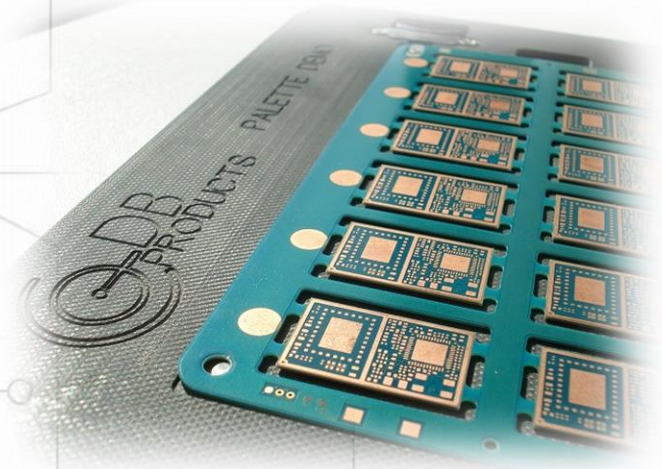




## Support de sérigraphie





Réduction des défauts d'impression grâce à un support optimal.

Réduction des cycles de nettoyage (déviation de planéité des outillages < 0.030 mm).

Réduit l'utilisation des produits de nettoyage.

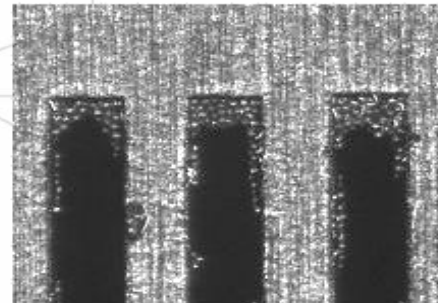
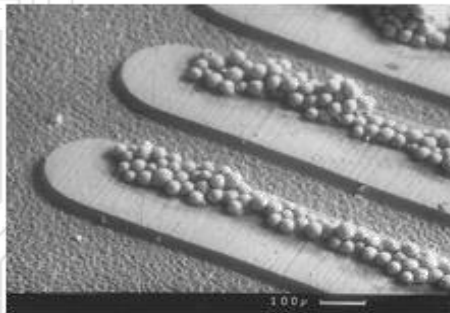
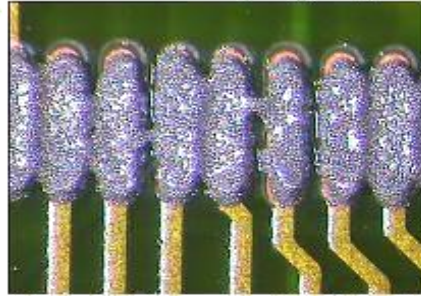
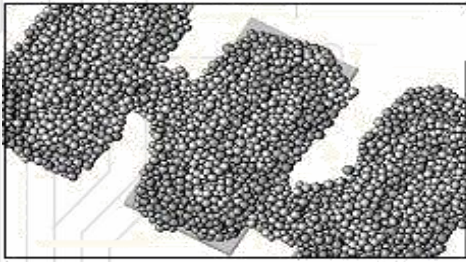
Augmentation de la durée de vie des écrans grâce à l'utilisation des supports d'écran.

La capacité d'alignement des machines est maintenue (tolérance de la hauteur pour l'alignement + 0.000 mm – 0.050 mm).

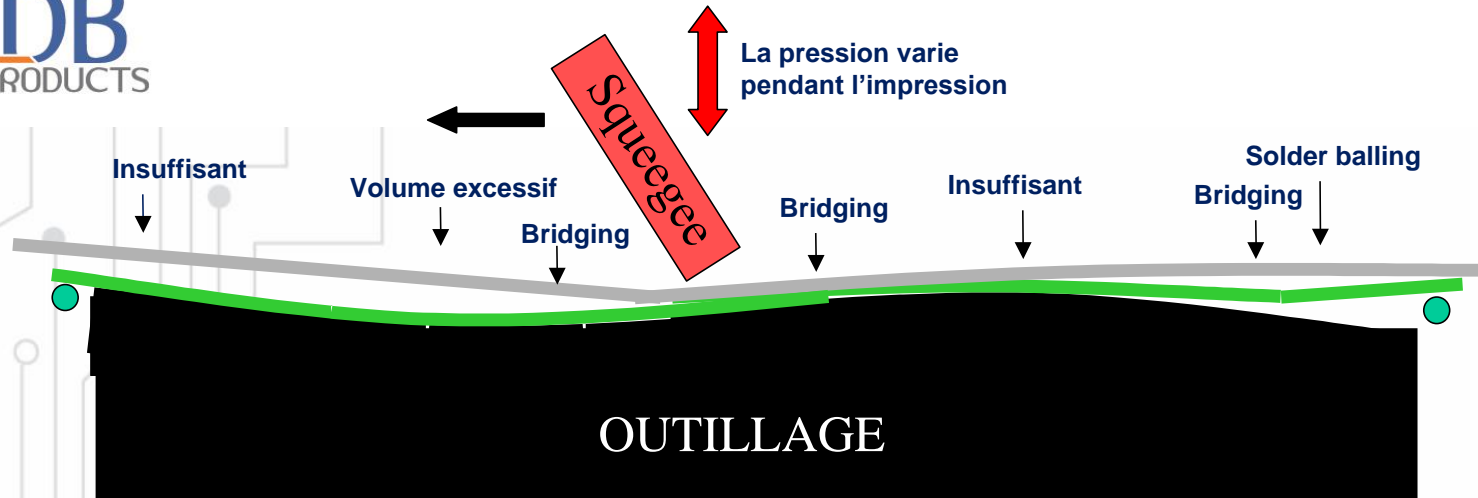
Rendement du produit optimisé. Pas de pinnes à placer, pas de préparation à faire.  
Le vide contrôlé supprime les défauts causés par des fuites.

CAD automatisé et process d'usinage rapide et complètement vérifiable.

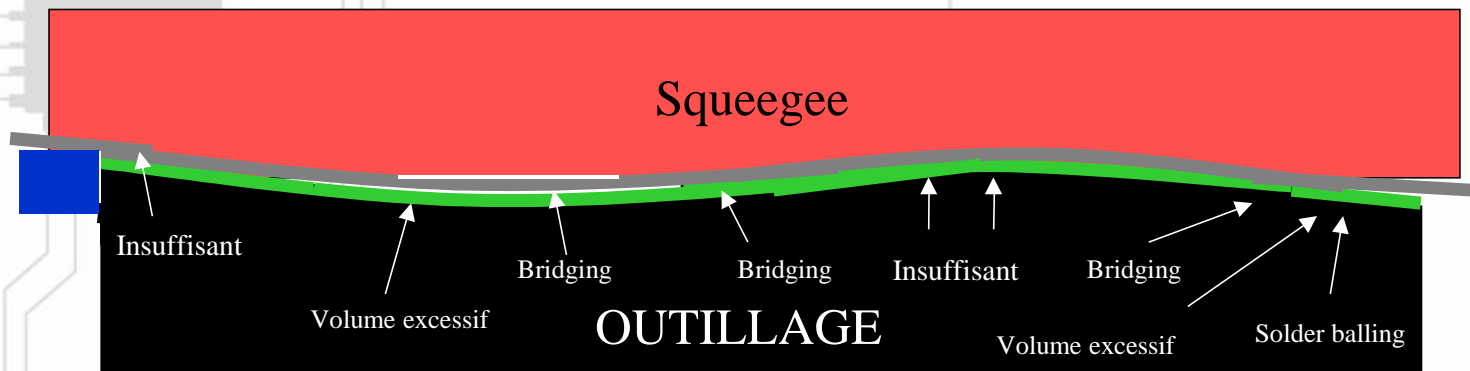
Livraison rapide avec une qualité certifiée: réalisation en 5 jours après réception des données.

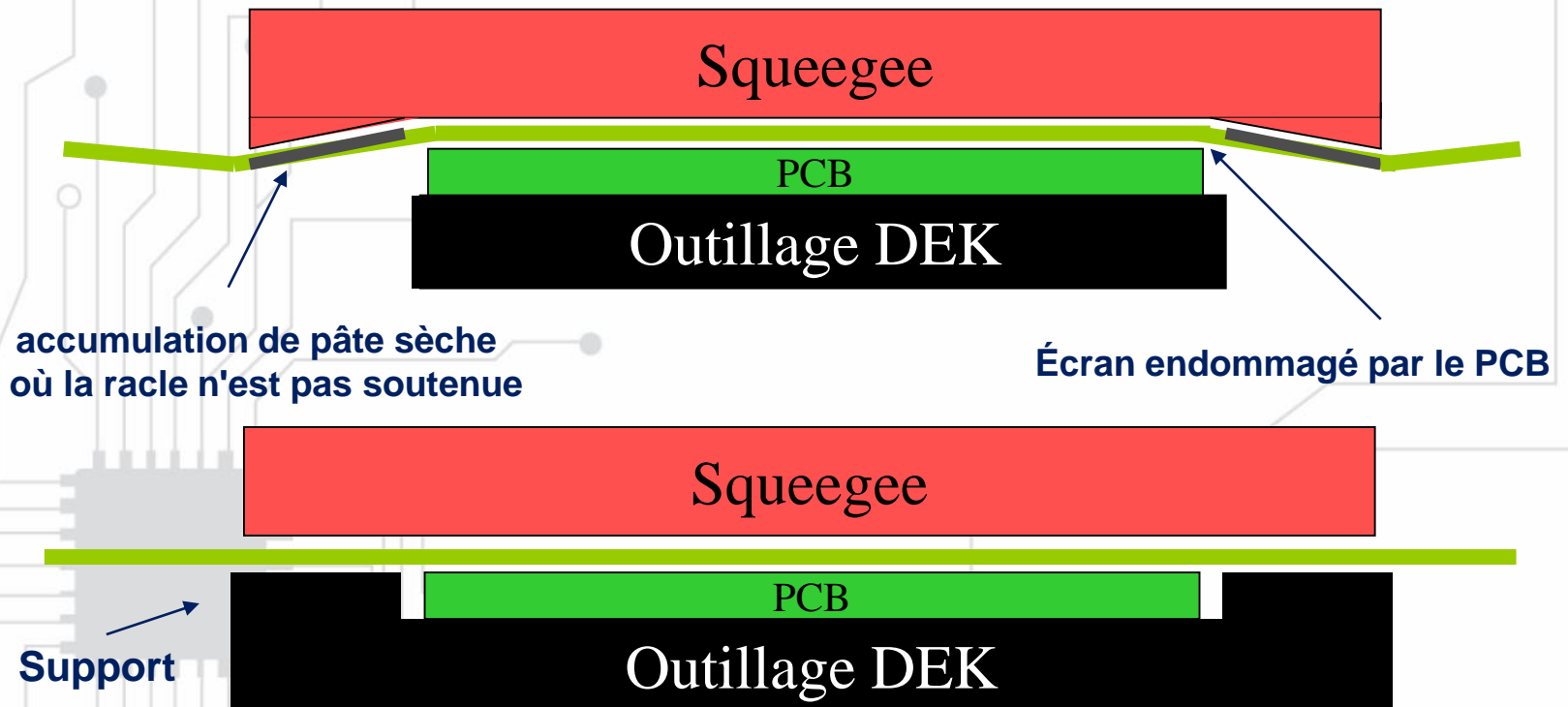


Solder balling, pont, tomb-stoning et manque de pâte peuvent être les résultats directs d'un mauvais support de la carte

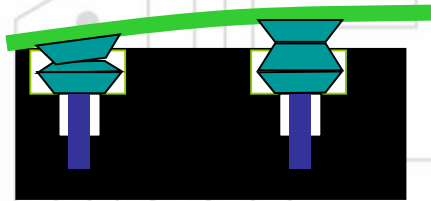


La pression de la racle et le gap entre le PCB et l'écran varie en fonction de la planéité de l'outilage. Les problèmes apparaissent lors de la sérigraphie de la carte. Le design et la planéité de l'outilage sont des facteurs important dans la réduction de ces défauts.





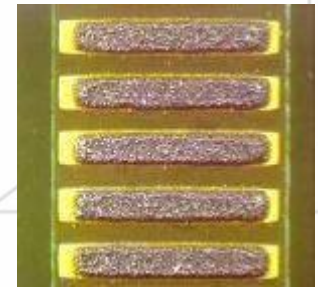
Les supports de racle préviennent les dommages de l'écran, et augmentent sa durée de vie. Sans supports de racle, la pâte s'accumule à l'extérieur des bords du PCB et sèche rapidement. Les supports permettent d'avoir une pression constante le long de la racle



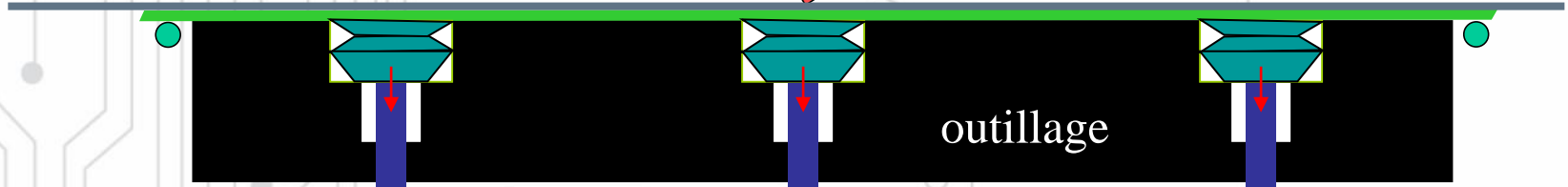
Permet un support parfait du PCB pour compenser la pression de la racle.  
Optimise la planéité du PCB et améliore le contact avec l'écran.  
Réduit ou élimine les mouvements vertical et horizontal du PCB pendant l'impression.  
Réduit les mouvements après impression permettant le contrôle de l'écran lors du démoulage.

Les ventouses à soufflets permettent d'avoir une bonne aspiration sur les PCB déformés. La lèvre crée un joint évitant ainsi l'aspiration de l'écran à travers les vias.

## Process Contrôlé



Il n'y a pas de séparation entre le stencil et le PCB  
Pendant la phase de sérigraphie





### Hauteur ensemble

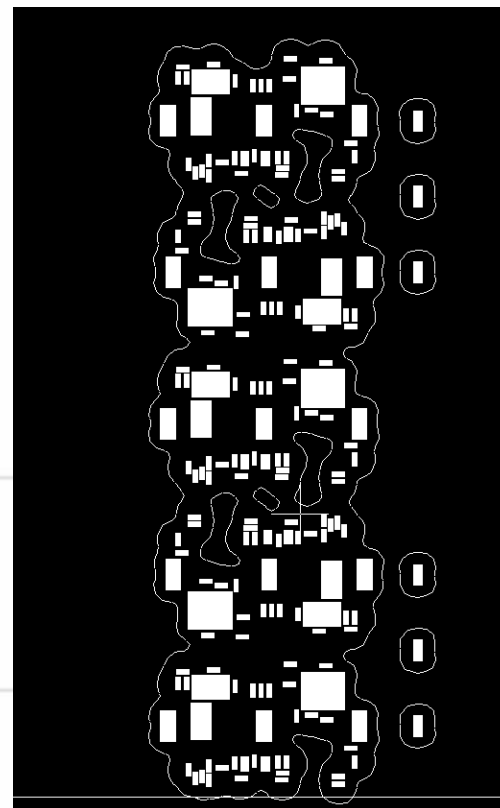
81 mm +0.00 / - 0.100 mm  
Tour 55.6 mm + Plaque 25.4 mm (1")

### Chandelles

+0.00 / - 0.050 mm

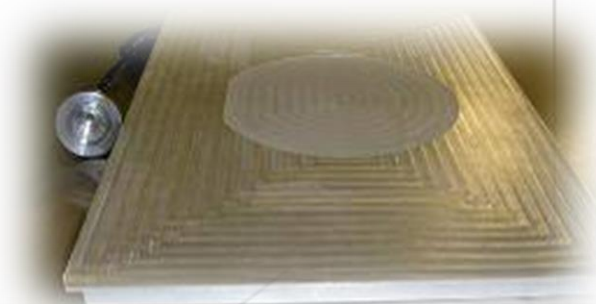
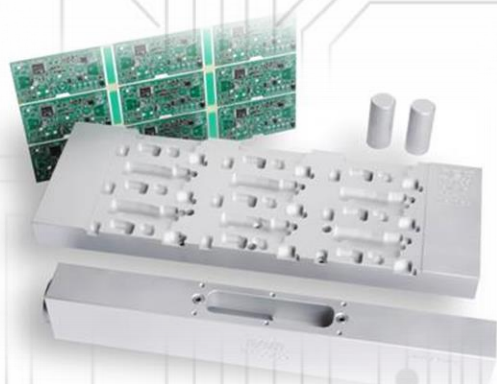
### Planéité

0.050 mm part rapport à la cote nominale  
Pour les outillages avec beaucoup d'évidements ou de grande dimension on passe à 0.100 mm  
Pour les applications semi-conducteur planéité  $\leq$  à 20 microns





L'augmentation des applications complexes nécessite de plus en plus d'outillages spécifiques.



Un process complet pour la sérigraphie.  
Tooling  
Palettes  
PumpPrint  
Association de solutions.

DB Products - 68 Allée des Cycadées - ZA en Prêle - 01480 SAVIGNEUX

[www.dbproducts.fr](http://www.dbproducts.fr)